

高信頼性、低コスト化実現の鉛フリーはんだのご提案

インターネブコン・ジャパン2012に出展します。

株式会社日本スペリア社は、インターネブコン・ジャパン2012(1月18日～20日 東京ビッグサイト 東展示棟)に出展致します。弊社ブースでは、銀を含まない、実績13年を迎える高信頼性鉛フリーはんだ「SN100C(Sn-0.7Cu-0.05Ni+Ge)」、及び、新製品SN100Cアドバンテージシリーズ 第1弾、銀を添加した鉛フリーはんだ「SN99CN(Sn-1.1Ag-0.7Cu-0.05Ni+α)」について、高い接合信頼性を示す試験結果とともにご紹介させていただきます。また、活性力を向上させた第2世代完全ハロゲンフリーはんだ付材料やソルダペースト、ボールはんだ、プリフォームはんだ、極細やに入りはんだ等、用途に合わせた各種展示を致します。さらに、コストや軽量化等のメリットが期待されるアルミニウム接合のご提案をさせていただきます。この機会に、高い接合信頼性を含めた低コスト化の実現に、弊社鉛フリーはんだおよびはんだ付材料のご検討をお願い致します。弊社ブースへのご来場をお待ちしております。

【開催概要】

会期：2012年1月18日(水)～20日(金) 10:00～18:00(最終日は17:00まで)

場所：東京ビッグサイト 東6ホール はんだゾーン ブースNo. 東30-13

【出展内容】

SN100Cアドバンテージシリーズ® 鉛フリーボールはんだSN99CN / ソルダペーストSN99CN P502 D4 **新製品**

「SN100Cアドバンテージシリーズ」第1弾、Agを添加した鉛フリーはんだ「SN99CN」は、高速度におけるブル試験(Cu-OSP基板)の結果、1.SN99CN>2.SN100C≥3.Sn-37Pb>4.Sn-3.0Ag-0.5Cuの順に吸収エネルギー量が大きく、高い接合強度を得ることができます。ボールはんだとソルダペーストを展示します。

鉛フリーやに入りはんだ 活性持続性向上 SN100C(551CT) **新製品**

フラックス活性力の持続性に優れ、こて離れが良好でつもの発生を抑制します。引きはんだ付やブリッジの修正等に最適な高信頼性や入りはんだです。

第2世代 完全ハロゲンフリー 鉛フリーソルダペースト SN100C P602 D4 **ハロゲンフリー HALOGEN FREE**

活性力を向上させた、完全ハロゲンフリータイプ(ハロゲン元素、F、Cl、Br、Iを含まない)の鉛フリーソルダペーストです。リード端面のぬれ上がり良好、サイドボールの発生を抑制。SN100C(Sn-0.7Cu-0.05Ni+Ge)の優れた合金特性を示し、錫銀銅系鉛フリーはんだと同等の温度プロファイルで使用できます。

第2世代 完全ハロゲンフリー はんだ付用フラックス NS-F900 **ハロゲンフリー HALOGEN FREE**

ぬれ性(酸化銅)に優れたハロゲンフリーはんだ付用フラックス。ハロゲン元素(F、Cl、Br、I)を含有していない、完全ハロゲンフリータイプの高信頼性ポストフラックスです。リード部のぬれ上がりやはんだ切れが良好、チップ部品及びディスクリット部品を搭載したプリント配線板の鉛フリーはんだ付に最適です。



アルミニウム接合のご提案

アルミニウムは銅に比べて、低コスト 約1/3(2011年9月建値平均比較)で、軽量 約1/3(比重 Al:2.7, Cu:8.7)、さらに耐腐食性に優れており、HVAC(冷熱機器)用配管、放熱板、ヒートパイプ、モーター等の用途に大きなメリットを提供することができます。Cu-Al、Al-Al接合に適した、アルミニウム用ろう材、鉛フリーはんだ、フラックス等で接合した各用途をご紹介、銅からアルミニウム化への提案をします。

【お問合せ先】 招待券をご請求ください。

株式会社日本スペリア社 営業部 E-Mail: info@nihonsuperior.co.jp

大阪 TEL:06-6380-1121 / 東京 TEL:03-3642-5234 / 名古屋 TEL:052-882-6011